

证券代码：603061

证券简称：金海通

## 天津金海通半导体设备股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2026-003

投资者关 系活动类 别	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研   <input type="checkbox"/> 媒体采访   <input type="checkbox"/> 新闻发布会   <input checked="" type="checkbox"/> 现场访谈   <input type="checkbox"/> 其他                 </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> 线上分析师会议   <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会   <input type="checkbox"/> 路演活动   <input checked="" type="checkbox"/> 线上调研                 </div> </div>
参与单位 名称	<p>特定对象调研、线上调研、现场访谈：国金证券、华泰证券、中泰证券、天风证券、申万宏源证券、永赢基金、广发基金、江岳基金、富安达基金、泓德基金、浦银安盛基金、广东正圆私募、博时基金、华宝证券、爱建证券、中欧基金、财通基金、中安汇富私募、循远资产、长城基金、睿目投资管理、摩根基金、平安基金、淳厚基金、长盛基金、湖南源乘私募、湖南八零后资管、创金合信基金、上海呈瑞投资、上海睿源私募、平安资管、财通资管、上海五地私募、国泰基金、西部利得基金、上银基金、新华基金、深圳市鲲鹏恒隆投资、上海康橙投资、观富资管、上海途灵资管、国寿安保基金、华安基金、上海软沐资管、IGWT Investment、中金公司、光大保德信、申万菱信基金、深圳前海华杉投资、北京神农投资、深圳前海博普资管、绿色发展基金私募股权投资、九泰基金、上海顶天投资、深圳丞毅投资、诺安基金、交银施罗德基金、北京合创友量私募、江苏瑞华投资、上海洛书投资、Willing Capital、金鹰基金、上海常春藤私募、海南润沣私募、新疆前海联合基金、上海杭贵投资、北京东方睿石投资、大湾区发展基金、人保资管、中信保诚基金、上海嘉世私募、东兴基金、兴银理财、上海煜德投资、中信建投资本、上海合远私募、浙商基金、蜂巢基金、招商信诺资管、深圳市乾图私募、汇丰晋信基金、上海赛伯乐投资、农银汇理基金、磐厚资本、摩根士丹利基金、国泰君安资管、前海再保险、南方基金、上海汇瑾资管、深圳望正资管、华西证券、华宝基金、光大资管、北京城天九投资、</p>

	<p>国泰海通证券、浩成资管、大家资管、北京泽铭投资、前海联合基金、招商基金、友邦人寿资管、上海证券自营、东吴基金、东方红资管、中庚基金、中海基金、中银基金、中银资管、丹羿投资、于翼资产、仙人掌投资、信达澳亚、兴业基金、兴银基金、冲积资产、利幄基金、勤辰资产、华夏基金、华泰保兴、华泰柏瑞、华泰资产、华福资管、博道基金、同泰基金、同犇投资、国投瑞银、国联安基金、国金基金、圆信永丰、域秀资本、复胜投资、太平养老、太平洋资产、宁银理财、富国基金、彤源投资、德邦基金、德邦资管、慈阳投资、承珞资本、星石投资、朱雀基金、民生加银、民生通惠、汇安基金、汇添富基金、泉果基金、海富通基金、湘财基金、瀛赐私募、玖鹏资产、益民基金、盘京投资、聚鸣投资、臻宜投资、融通基金、西南证券自营、西部证券自营、观火投研、诺德基金、路博迈、鑫元基金、银华基金、银河基金、长信基金、长安基金、非马投资、鹏扬基金、鹤禧投资、龙航资产（以上排名不分先后）；</p> <p>业绩说明会：参与业绩说明会的投资者。</p>
时间	2026年4月16日至2026年4月28日
地点	公司会议室、腾讯会议、策略会现场、上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）。
上市公司接待人员姓名	<p>特定对象调研、线上调研、现场访谈：副总经理兼董事会秘书刘海龙先生；</p> <p>业绩说明会：董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍主要内容</p> <p>金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。</p> <p>公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测</p>

试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED 系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已与同类产品的国际先进水平同步。

## 二、公司 2026 年第一季度经营情况介绍

2026 年第一季度，受公司所处半导体封装测试设备领域需求增长等因素驱动，公司测试分选机产品销量实现增长，因此，公司 2026 年第一季度实现营业收入 2.84 亿元，较上年同期增长 120.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.83 亿元，较上年同期增长 221.54%。截至 2026 年第一季度末，公司总资产为 23.57 亿元，较上年末增长 9.64%；净资产为 17.08 亿元，较上年末增长 5.80%。

公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断强化技术壁垒与产品竞争力，公司持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。

## 三、调研及业绩说明会问答

1、问：请介绍下本期（2026 年第一季度）业绩增长主要原因。

答：公司 2026 年第一季度实现营业收入 2.84 亿元，较上年同期增长 120.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 0.83 亿元，较上年同期增长 221.54%。主要是受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求增长等因素影响，带动公司测试分选机产品销量增长所致。

2、问：目前客户下单的节奏如何（提前多久下单）？

答：一般情况下，客户会与公司进行持续性的常态化沟通，对公司产品的技术指标及交货周期等进行了解。对于量产机型及标准选配功能，公司具有快速交货能力。基于这种情况，客户通常会在需求相对确定时下单。

3、问：在决定购买测试分选设备方面，芯片设计公司和测试代工厂哪个话语权更多一些？

答：具体要看产品和项目情况。对于没有特别测试需求的量产机

型，测试代工厂的话语权会相对多一些；但是对于芯片设计公司特别测试需求的产品如算力芯片等，芯片设计公司主导测试分选设备的评估，在这种情况下，芯片设计公司通常会直接或者通过测试代工厂与公司沟通设备技术指标等需求。

4、问：公司现有产品的迭代是从哪几个方面进行的？

答：公司结合市场需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，通过深度定制化开发掌握并持续积淀特定细分领域芯片测试分选的前沿技术，持续扩容公司动态演进的技术储备池。

5、问：公司如何看待集成电路测试分选机市场的行业发展？

答：公司主要产品为集成电路测试分选机，属于集成电路专用设备领域的测试分选设备。半导体产业在历史发展过程中呈现了较强的周期性特征，这与国际贸易形势、下游应用市场需求波动以及国家产业政策等因素均存在一定的相关性。

在技术迭代、需求提升、场景渗透等因素的多重驱动下，2025年全球半导体行业延续增长态势，先进封装、AI及高性能计算等需求的增长给半导体设备带来广阔的市场空间。半导体行业协会（SIA）数据显示，2025年全球半导体销售额达到7,917亿美元，较2024年同比增长25.6%，创历史新高。此前世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025年全球半导体市场规模预计同比增长22.5%。上述驱动因素动能的持续释放，将推动未来几年全球半导体行业持续快速发展。

特别是随着先进封装、AI算力芯片等的发展，相关芯片测试的复杂度在攀升，芯片测试总耗时大幅提高，对高端测试资源的需求在快速增加；与此同时，相关芯片的测试在温度控制、热管理效率及动态适配能力等方面，对半导体测试分选设备提出了更高的要求。半导体测试设备公司已进入快速发展新阶段。

未来，集成电路产业将继续向更具精细化的模式发展。随着集成电路产业进一步精细化分工，为确保产品质量、生产效率和生产稳定性，半导体测试设备企业需要与集成电路设计企业、晶圆制造企业、封装测试企业经过长时间的协作、磨合，提供符合客户使用习惯和生产标准的定制化测试方案开发，产业链协同效应将构筑行业新壁垒。同时，测试任务的复杂性对分选机设备不断提出更高要求，测试分选机

	<p>设备将呈现高效率、高稳定性、柔性化及多功能的发展趋势。</p> <p>6、问：能否具体介绍下公司 EXCEED-9000 系列相比 EXCEED-8000 系列以及之前系列产品技术指标上有什么提升？</p> <p>答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司持续深耕产品创新与技术迭代升级，不断强化技术壁垒与产品竞争力，公司持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代并适时推出新产品。EXCEED-9000 系列是基于 EXCEED-8000 系列的整体平台性升级，在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸等方面均有一定程度的迭代升级。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2026 年 5 月 7 日